

证券简称：晶合集成

证券代码：688249

合肥晶合集成电路股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	安徽广播电视台、国元证券、安徽润华管理咨询、北京龙和投资管理、福建盈利泰投资、海南壹宏创投、上海和志文化、一尺教育以及 17 名个人投资者。
会议时间	2026 年 3 月 6 日
会议地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	朱才伟 董事、董事会秘书、财务负责人、副总经理
投资者关系活动主要内容介绍	<p>介绍公司情况：</p> <p>晶合集成主要从事 12 英寸晶圆代工业务及配套服务，拥有 150nm-28nm 多元化制程工艺，目前具备显示驱动芯片(DDIC)、CMOS 图像传感器芯片(CIS)、电源管理芯片(PMIC)、逻辑芯片 (Logic)、微控制器芯片(MCU) 等工艺平台晶圆代工的技术能力，产品应用涵盖智能手机、平板显示、安防、汽车电子、家用电器、工业控制、物联网、存储等领域，可为客户提供丰富的产品解决方案。</p> <p>晶合集成目前总产能约 16 万片/月，现在正在进行四期项目的建设。</p> <p>经初步核算，晶合集成预计 2025 年全年实现营业收入约 109 亿，较去年同期增长 17.69%；预计实现归属于母公司所有者的净利润约 7 亿，较去年同期增长 30.66%；综合毛利率预计为 25.52%。</p> <p>问题 1：请问目前国际局势是否会影响公司的生产与采购？公司现在产能利用率如何？</p> <p>答复：公司近期各项业务经营正常，产能利用率维持在</p>

	<p>高位。</p> <p>问题 2: 请问公司四期项目扩产的制程和终端应用产品? 答复: 公司四期项目将建设一条产能为 5.5 万片/月的 12 英寸晶圆代工生产线, 布局 40nm 及 28nm 的 CIS、OLED、逻辑等工艺, 产品可广泛应用于 OLED 显示面板、AI 手机、AI 电脑、智能汽车、人工智能及存储等领域。</p> <p>问题 3: 请问公司目前的研发进展如何? 答复: 目前, 55nm 全流程堆栈式 CIS 芯片实现批量生产; 55nm 逻辑芯片实现批量生产; 40nm 高压 OLED 显示驱动芯片实现批量生产; 28nm 逻辑工艺平台完成开发。</p> <p>问题 4: 请问公司产品会有提价吗? 答复: 目前, 公司部分产品的代工价格已有所上调, 后续公司将通过优化产品结构、提升运营效率、拓展应用领域等方式积极应对市场变化, 并结合客户需求与市场动态, 制定合理的定价策略。</p> <p>问题 5: 请问公司 5 大产品中, 哪个品种成长最快? 答复: 从过去几年来看, DDIC 的营收占比在不断下降, CIS 占比不断上升, 从 2023 年半年度营收占比约 4%, 成长到 2025 年度营收占比超 20%, 成长较快。</p> <p>问题 6: 请问公司的生产线在不同产品之间切换是否有难度? 答复: 公司目前同类制程的产品生产线切换难度不大, 不同厂区可以相互支援, 这也是公司选择集中建厂的原因。</p>
附件清单 (如有)	无
日期	2026 年 3 月 9 日